

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2020-025

通富微电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员未提出异议：公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2019 年，半导体行业景气度呈现“前低后高”的走势，上半年市场需求整体低迷，下半年受国产化驱动国内市场需求大幅增长，5G 商用带来客户订单明显增加；此外，高端处理器产品市场在 AMD 7 纳米技术带动下，需求呈现强劲增长。在此背景下，2019 年下半年，公司国内客户订单饱满；通富超威苏州、通富超威槟城海外客户订单大幅增长。2019 年公司实现营业总收入 826,657.46 万元，比上年同期增加 14.45%。公司 2019 年整体经营业绩亦呈现“先抑后扬”态势，下半年扭亏为盈。同时，公司加大了针对高性能计算、存储器、高清显示驱动等市场应用的先进封装产品的研发布局，2019 年研发投入比上年同期增加 14,305.26 万元，同比增加 25.44%。综上，公司 2019 年全年收入保持增长，2019 年归属于上市公司股东的净利润为 1,914.14 万元，比上年同期减少 84.92%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	8,266,574,620.47	7,222,862,993.75	14.45%	6,519,255,165.45
归属于上市公司股东的净利润	19,141,404.20	126,939,560.26	-84.92%	122,129,358.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,404,521.14	42,513,128.00	-406.74%	3,248,193.62
经营活动产生的现金流量净额	1,415,222,975.20	752,859,484.21	87.98%	1,009,689,947.96
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.13
加权平均净资产收益率	0.31%	2.12%	-1.81%	3.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	16,157,098,082.94	13,968,377,342.51	15.67%	12,146,404,900.52
归属于上市公司股东的净资产	6,110,947,111.94	6,134,345,314.38	-0.38%	5,919,382,239.15

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,653,683,849.12	1,933,550,713.87	2,467,276,167.42	2,212,063,890.06
归属于上市公司股东的净利润	-53,227,284.12	-24,413,218.92	50,310,131.62	46,471,775.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,844,424.60	-51,069,845.31	26,735,969.48	-13,226,220.71
经营活动产生的现金流量净额	353,232,599.75	420,905,286.84	-38,770,014.38	679,855,102.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况**(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,346	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	27.35%	315,541,893	0	质押	136,510,000	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	21.72%	250,621,589	0			
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.41%	50,935,309	0			

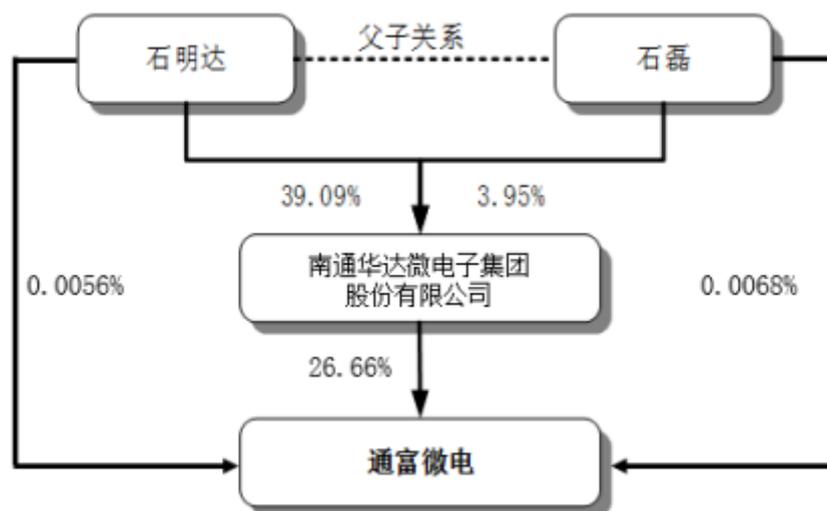
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	24,733,126	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.36%	15,712,377	0		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	15,124,142	0		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.21%	13,986,034	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.83%	9,609,591	0		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	0.83%	9,529,866	0		
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	0.58%	6,725,530	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人。除此之外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露截至目前公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 概述

(1) 公司规模继续扩大，业务体量逆势增长

2019年，半导体行业景气度呈现“前低后高”的走势，上半年市场需求整体低迷，下半年受国产化驱动国内市场需求大幅增长，5G 商用带来客户订单明显增加；此外，高端处理器产品市场在AMD 7纳米技术带动下，需求呈现强劲增长。

在此背景下，2019年下半年，公司国内业务订单饱满，第四季度，崇川工厂营收创下了历史新高。2019年，公司抓住了AMD 7纳米产品大卖的机遇，积极为AMD做好封测服务，通富超威苏州、通富超威槟城订单大幅增长，两个公司全年合计实现营业收入43.29亿，同比增长33.36%。2019年，公司实现营业总收入82.67亿元，同比增长14.45%，连续两年收入规模位列国内行业排名第二、全球行业排名第六；总资产达到161.57亿，同比增长15.67%。

(2) 工厂运营积极努力，推动营收逆势增长

崇川工厂圆片部门满产，圆片产品营收与产量快速上升，创新高；QFN产品快速增量，成为公司新的增长点；车载品项目导入硕果累累，成为英飞凌高端车载品的国内唯一供应商。

合肥通富显示驱动电路封测线客户相继量产，另有8家客户在导入中；存储DRAM封测工程线建成，客户产品考核已完成；合肥通富通过IATF16949体系审核。合肥通富全年营业收入同比增长28.42%。

南通通富已实现4G PA量产；超高线数TFBGA考核通过，成功打开了通向客户DTV品的大门。南通通富全年营业收入同比增长24.99%。

2019年是通富超威苏州、通富超威槟城并购后从第三年踏入第四年承上启下的关键一年；是产品更新换代的重要一年。通富超威苏州成为第一个为AMD 7纳米全系列产品提供封测服务的工厂，通富超威苏州和通富超威槟城承接了更多的AMD订单，合作前景一片光明。2019年，通富超威苏州营业收入同比增长36.49%，导入6个封装、8个测试新产品，成功接洽42个新客户，新客户产量需求大幅增加；通富超威槟城营业收入同比增长30.12%，成功完成了14种产品多芯片和先进制造工艺的开发，获得了AMD的最佳质量奖，顺利通过汽车认证（IATF16949）审核。2019年5月27日，通富超威槟城以不超过马币1,330万令吉的收购金额，完成了FABTRONIC SDN BHD股权收购工作。

(3) 围绕市场客户应用，技术开发取得新进步

经过多年创新发展，公司成为技术全面的封测企业。

- 公司拥有全球领先的CPU/GPU量产封测技术，公司在CPU、GPU、服务器领域成功开发了具有竞争力的7纳米封测产品，有力地支持了AMD的发展；成为国内首个封测7纳米及9芯片服务器产品的工厂；成为业界首个将Indium TIM 应用在FCBGA上的工厂；

- 公司SiC/GaN封装技术、IPM、刀片式水冷式IGBT模块、Clip、Dr.Mos、Toll and LPAK研发完成，部分已量产，这些技术进一步巩固了公司在Power产品领域的地位；

- 紧跟半导体先进制程的发展，具备了Fan-out、7纳米 Bumping等先进封装技术，2.5D技术积极研发中；

- 具备了LCD /OLED DRIVER的封装技术，特别是12吋TDDI，也具备了8K LCD Driver COF的生产技术能力。

- 为抢抓集成电路产业发展的重大机遇，更好的专注于信息产业先进技术的研发与整合，公司在南通中创区注册成立信息产业先进技术研究院，于2019年4月投入试运行。

截止到2019年12月31日，公司累计申请专利875件，获专利授权（有效）479件。

公司具有成熟的各种封装技术，相互融合，形成公司特有的系统级封装技术平台，为公司形成新的竞争力和开拓业务发展提供更多机会。

(4) 保持适度投资规模，厦门工厂如期建成

尽管面对2019年半导体发展的不确定性，公司从产业本质出发，坚信集成电路发展的趋势不会变，稳中求进，保持适度投资。公司全年固定资产投资数十亿元，新建工程13万多平米，改造工程3万3千多平米。其中，江苏省重大工程项目——南通通富二期工程完成室外配套工程，厦门通富2019年12月23日举行了揭牌暨一期工程试投产仪式，崇川工厂根据市场需求进行了部分厂房扩建，这为公司进一步扩大生产规模、积极应对市场需求提前做好准备。

(5) 积极争取各级支持，公司行业地位进一步提升

建设江苏省集成电路先进封装测试重点实验室获政府部门批准，这是江苏省半导体领域唯一的省重点实验室；FO技术开发及产业化项目被列为江苏省科技成果转化项目；通过“02”、科技、技改、人才等项目，公司获得各级财政共计1.556亿元的资金支持。

公司荣获“国家绿色工厂”、“江苏省智能工厂”荣誉称号，被授予“2018年市长质量奖”。通富超威苏州荣获“江苏省智能工厂”荣誉称号。公司荣获英飞凌2019年OSAT供应商奖、中兴通讯2019年度最佳服务支持奖、AIROHA 2019年最佳供应商等奖项。

(6) 利用资本市场发展情况

为促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，2019年，公司开展了股份回购工作，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额4,000万元-8,000万元。截至目前，公司累计回购股份5,920,092股，占公司总股本的0.51%，支付总额49,900,111.60元（不含交易费用）。

(二) 公司未来发展的展望1、公司所处行业发展趋势**1、公司所处行业发展趋势****(1) 国家政策**

进入二十一世纪来，我国设立集成电路产业领导小组，组建国家集成电路产业投资基金，密集出台了若干产业政策。各方面的政策、资金及配套资源得以集中，为集成电路行业的攻坚克难奠定良好的基础：

时间	政策及支持措施	具体内容
2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	到2020年封装测试技术达到国际领先水平
2014年	国家集成电路产业投资基金一期	募资规模超过1,000亿元，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计，封装测试设备和材料等产业
2015年	《中国制造2025》	提出着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力
2016年	战略新兴产业和信息化的“十三五”规划	大力发展芯片级封装、圆片级封装等研发和产业化进程，推动封装测试等产业快速发展
2018年	《政府工作报告》	加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展
2019年	国家集成电路产业投资基	募集完毕，募资规模超过2,000亿元，较一期显著提升，将进一步推进国家对集成电

	金二期	路产业发展的战略引导和支持作用
2020年	《关于推动5G加快发展的通知》	明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G完全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施

(2) 市场容量

①全球市场

近年在以5G、汽车电子、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，全球半导体产业恢复增长。根据WSTS统计，从2013年到2018年，全球半导体市场规模从3,056亿美元迅速提升至4,688亿美元，年均复合增长率达到8.93%。

②我国市场

随着经济的不断发展，中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场，衍生出了巨大的半导体器件需求。根据中国半导体行业协会统计，从2013年到2018年中国半导体集成电路市场规模从2,509亿元扩大至6,532亿元，年均复合增长率约为21.09%，快于全球集成电路市场规模增速。

根据中国半导体行业协会统计，2019年中国集成电路产业销售额为7,562.3亿元，同比增长15.8%。其中，设计业销售额为3,063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额为2,149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2,349.7亿元，同比增长7.1%。

随着“芯片国产化”浪潮的席卷，半导体产业正进入以中国为主要扩张区的第三次国际产能转移。据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）发布的报告，目前全球处于规划或建设阶段，预计将于2017年~2020年间投产的半导体晶圆厂约为62座，其中26座设于中国，占全球总数42%。位于中国的新建晶圆厂数量于2018年达到高峰，共13座晶圆厂加入营运，其中多数为晶圆代工厂。随着国内集成电路新增产线的陆续投产，后续数年国内集成电路制造业增速将一直高于产业平均水平。

③5G带来的持续增长动力

随着各国运营商加快5G部署，各手机厂商加快推出适用5G的终端，5G技术有望在2020年开始在全球范围内规模化商用。每一代通信技术的升级都将会带来更快的网络速度和更好的使用体验，更多的手机应用形态有望在新一代通信技术支持下诞生，新技术切换的前几年手机往往有相对较高的销量增长。2019年是我国5G元年，但网络覆盖不完善、终端数量较少、终端价格昂贵，随着网络建设的逐渐完善、终端机型数量增加和价格下降，2020年将可能迎来5G消费的爆发。

另一方面，5G手机中半导体消费量将高于4G手机。因为信号频谱增加，5G手机中的射频前端、天线和功率放大器价值量将会有显著提升。同时伴随高速下载大容量文件的需要，5G手机的闪存用量将比4G手机显著增长。

此外，5G时代会有海量设备的接入，有望带动各种智能终端内处理器、模拟芯片和传感器等半导体产品的用量提升，从而带动下游封装环节的需求增长。

④汽车电子的广阔市场

随着消费者对汽车智能化、电子化、信息化、网络化要求逐步提高，计算机、通信、控制、微电子、电子传感器等技术融入汽车产业，使汽车由传统意义上的机械产品向高新技术产品演进。另一方面，汽车新能源化引起的动力系统的电气化及驱动方式的变化为汽车电子产品发展带来重大机遇。汽车电子市场将是近年来发展最快的集成电路芯片应用的市场之一。根据盖世汽车研究院预测，2017年-2022年我国汽车电子市场将以10.6%速度增长，增速超过全球，2020年我国汽车电子市场规模将超过8,000亿元。

(3) 供需情况

①中国市场供不应求

中国半导体市场供不应求，进口依赖依然明显。根据海关统计，2018年国产半导体自给率约为15%。根据海关总署的数据，仅半导体集成电路产品的进口额从2015年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位，不断扩大的中国半导体市场严重依赖于进口，中国半导体产业自给率过低，进口替代的空间巨大。

②国际形势推动国产替代加速

近年来各类国际事件使得我国认识到了集成电路行业自主可控的重要性，进一步推动了我国集成电路产业链国产替代的进程。2018年3月22日，特朗普签署总统备忘录，中美贸易战拉开序幕。自此美国反复对我国半导体行业禁运、加征关税、限制我国企业在美投资及开展业务。2019年8月以来，日本取消对韩出口白名单。日本在光刻胶、氢氟酸及聚酰亚胺市场占有率90%份额，长期会影响韩国半导体厂商的经营规划。

尽管目前中美贸易战有所缓和，但接踵而至的国际事件使得业界认识到国内企业技术研发水平直接关系到中国集成电路水平的提高和国家信息安全，尽快实现集成电路行业自主可控具有重要性和紧迫性，极大加快了集成电路产业国产化的进程。以华为、中兴为代表的厂商正加快将订单转移给国内供应商。

(4) 行业竞争格局

封测行业具备资本密集、技术更新快的特点，规模及资本优势至关重要。随着近年来同行业公司通过并购整合、资本运作不断扩大生产规模，封测行业集中度显著提升。根据芯思想统计数据，2018年，全球半导体封测前5大厂商市场占有率达到65.80%，前10大厂商市场占有率达到81.00%。

综上所述，集成电路行业容量巨大，在5G、汽车电子、大数据等应用的带动下，市场需求将持续增长；中国市场供不应求，急需发展自己的产业链，同时，受中美贸易战影响，中兴、华为相继成为美国打压的目标，这进一步突出了集成电路行业的重要性和战略意义；2019年以来，集成电路国产替代步伐明显加快，国产化需求大大提升，国内封测企业订单也显著增加。

2、公司发展战略及规划

(1) 公司发展战略

公司紧跟市场与客户需求，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司总体战略为“立足本地、异地布局、兼并重组，力争成为世界级封测企业”。公司坚持发展主业的指导方针，通过并购通富超威苏州和通富超威槟城，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，进一步增强了公司在客户群体上的优势；同时在技术层面，公司下属企业通富超威苏州成为国家高端处理器封测基地，打破国外垄断，填补了我国在CPU、GPU封测领域的空白；公司坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业使命，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；公司抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，力争成为世界级封测企业，努力使排名不断向前。

(2) 公司业务发展趋势

集成电路是一切电子信息产品的基石，集成电路产业是国家战略支柱性产业。公司承担国家重大专项任务，是国家建设自主可控集成电路产业链的重要组成部分。2020年开局，面对新冠肺炎疫情，公司迅速成立了以石磊总经理任组长的“疫情防控领导小组”，指导全面加强疫情防控工作。在确保员工身体健康的前提下，以“坚决遏制疫情、确保生产经营”为基本原则，制定了周密的管控措施，层层抓落实，采取一对一严防死守，确保所辖员工不发生任何问题。

集成电路行业是一个生态系统，必须全产业链运营顺畅，相关企业才能正常生产。我们将密切关注全球疫情走势，进一步加强同客户、材料、设备供应商等上下游合作，确保供应正常；借力5G、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能等七大产业“新基建”建设的发展机遇，上下游协同，稳固公司发展。

同时，得益于“先进架构”叠加“先进工艺”，AMD 7纳米芯片产品性能、功耗已处于行业最优，且价格相对竞争对手具备优势，市占率提升显著。AMD全球市场高级副总裁Ruth Cotter表示，AMD现阶段目标是要在服务器、台式机、笔记本市场上分别占据26%、25%、17%的份额，重拾Opteron（皓龙）处理器时代的辉煌。通富超威苏州、通富超威槟城作为AMD最主要的封测供应商，其业务规模也将呈现高速增长。

综上，公司2020年业务发展趋势良好，我们将紧紧盯住2020年营收目标不放松，寻找机会，实现公司更大的发展。

(3) 公司2020年度经营目标

公司计划2020年实现营业收入108.00亿元，较2019年实绩增长30.64%。该生产经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。

2020年，是公司抢抓发展机遇、推进公司一体化协同发展、扎实做好企业规模和经济效益双提升、实现高质量发展的重要之年。

①快速响应市场，积极抢抓订单

加快市场开拓和产品结构调整，确保市占率不断提高。欧美市场，在继续保持现有封装业务的基础上，一方面和客户继续开展技术研发，在功率封装技术上保持领先，另一方面将在WLCSP、FCCSP等产品上有可期待的突破；专职团队推广存储、Fan-Out以及LCD Driver产品线，充分体现产品先进性和产品价值，为今后成长打下基础；夯实公司在国产CPU客户领先供应链的地位；抓住市场应用趋势，加大技术行销、深度挖掘5G、电动汽车、IoT/AI等具有高成长的应用领域。

②重视技术研发，推动创新发展；确保已投资项目达标、持续合理投入

加强技术研发组织建设，确保研究院实质运行，按标准、按时序节点建设省集成电路先进封装测试重点实验室。潜心技术研发，加速研发产品和技术的应用与产业化，为客户提供一站式解决方案；以市场为导向，继续保持科学合理的投入，确保已投资项目尽快达产上量，产生效益。

③着重用好资本市场，形成良性循环发展

为促进公司健康稳定长远发展，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司在2019年开展了公司部分股份回购工作，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。截至目前，公司累计回购股份5,920,092股，占公司总股本的0.51%。

公司分别于2020年2月21日、2020年3月9日召开了董事会及股东大会，审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，计划募集资金不超过40亿元。我们将积极开展后续审核、募集等工作，为公司的进一步发展保驾护航。

(4) 为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为实现上述经营目标，并为今后的生产经营做适当准备，公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富超威苏州及通富超威槟城计划2020年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计28.26亿元。

公司与合肥政府、厦门政府建立了合作关系，合肥通富获出资12亿元，厦门通富注册资本8亿元全部出资到位；南通通富获得1.56亿国家专项建设基金支持；收购通富超威苏州及通富超威槟城各85%的股份获得产业基金2.7亿多美金的支持；公司与商业银行及政策性银行均保持长期密切合作；公司正在开展非公开发行募工作，将为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

3、公司的风险因素及应对措施

(1) 行业与市场波动风险

全球集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。半导体行业与市场的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。半导体是全球高度分工的产业，其增长与全球的经济成长基本同步。中美贸易战一方面给整个半导体产业链带来了较大的不确定性，造成信心不足；另一方面，中美贸易战推动半导体国产化浪潮，有利于我国半导体国产化发展。基于行业周期性特点，存在波动风险。此外，新型冠状病毒疫情可能对于集成电路产业链造成影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业波动给公司带来的经营风险。

(2) 新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求越来越高。公司通过承担国家“02”专项、收购AMD封测资产，已经取得一定的科研成果，已经具备了提供大规模先进封测的能力。同时，公司大部分产品技术比较成熟，具备丰富生产经验，但个别的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中，如出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成一定影响。对此，公司通过引进高层次研发人才、并购高端封测资产，主攻技术含量高、市场需求大的新产品，努力在技术研发层面上少走弯路；公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品，配合客户做好产品认证工作，提前预测产业化过程中有可能出现的问题，做好对策分析工作，缩短客户认证时间，确保新产品如期产业化。

(3) 原材料供应及价格变动风险

公司封装测试所需主要原材料为引线框架/基板、键合丝和塑封料。公司主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道。但公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料部分依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。

(4) 外汇风险

2017年、2018年及2019年，公司出口销售收入占比分别为82.47%、86.41%、81.27%，以外币结算收入占比较高。如果汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路封装测试	8,111,628,624.63	-20,504,878.75	12.70%	13.23%	-117.91%	-2.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，根据该通知，公司对财务报表格式进行了修订。财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

②财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

具体内容详见2019年年度报告第十二节 财务报告“重要会计政策、会计估计的变更”。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月27日，公司下属子公司通富超威槟城收购了FSB100%股权。2019年12月20日，公司下属子公司南通通富设立全资子公司通富科技，注册资本100万元，主营业务为集成电路、半导体产品的技术研发、技术服务；集成电路、半导体产品的生产。报告期内，公司财务报表合并范围新增通富科技、FSB 2家公司。本期合并范围及其变化情况详见2019年年度报告第十二节 财务报告“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-3 月净利润 (万元)	-2,000.00	至	0.00
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,322.73		
业绩变动的原因说明	2020 年一季度市场需求较 2019 年一季度回升，预计公司 2020 年一季度营收同比增长 20% 以上，但新冠肺炎疫情对公司生产经营活动造成较大影响，致使公司 2020 年一季度未能按计划实现扭亏为盈，但较 2019 年一季度明显减亏。		

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2020 年 3 月 27 日